

江苏先锋精密科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：先锋精科

证券代码：688605

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（<u>请文字说明其他活动内容</u>）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>方正证券研究部、平安证券、华安证券、国联证券、中信证券、溪牛投资、天壹资本、长江证券、策源资本、东财证券、达城基金、牧鑫资产、华鑫证券、中信建投、博笃投资、上海远海私募基金、高毅资产、成天九投资、光大保德信、方正证券、云岫资本、尚颀资本、永赢基金、人保资产、上海添笙投资、远望角投资、中银资管、蜂巢基金、中欧基金、招商基金、誉辉资本、兴银基金、兴业基金、中金公司、中汇人寿、重阳投资、华泰证券、富达资本（Fidelity）、长城基金、中邮证券、易方达基金、华夏基金</p> <p>Welight Assets Limited(P), HK; Coatue Management LLC(P), USA; Toroa Management(P), Hong Kong; Pictet Group(P), Switzerland; Autonomy Capital(P), United Kingdom; Tokio Marine Asset Mgmt(P), Japan; FountainCap Research and Investment Co Ltd(P), HK; Polunin Capital Partners Ltd(P); AllM AI Squared Mgmt Ltd(P), HK; Sapere Capital Management Limited(P), HK; Monolith Management Limited(P), HK; Boyu Capital Investment Mgmt Co Ltd(P), China; LyGH Capital(P), Singapore; UBS Securities; UBS Asset; Elevation Capital; New Silk Road; Capital Group; Federated Hermers; UG.</p>
<p>时间</p>	<p>2025年3月</p>

<p style="text-align: center;">地点</p>	<p>2025年3月19日靖江市新港大道195号公司会议室、 2025年3月26日至3月27日上海浦东新区</p>
<p style="text-align: center;">上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事，副总经理，首席技术官：XU ZIMING 董事，董秘：XIE MEI 首席财务官：杨丽华</p>
<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>先锋精科成立于2008年，总部位于江苏靖江，自成立至今始终专注于国内半导体设备核心零部件赛道，作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程。公司主要客户包括北方华创、中微公司、拓荆科技等国产半导体设备龙头厂商，产品主要分为内衬、加热器、匀气盘及腔体等关键工艺部件以及腔体盖板、接地环、喷嘴、气体分配环等工艺部件和结构部件。</p> <p>未来，公司将继续聚焦半导体设备零部件领域，与此同时也将充分发挥精密零部件技术的扎实基础及创新能力优势，积极在医疗设备、光伏等其他高端装备领域探索和开发新产品，开拓更多收入增长点，为股东创造更优良的业绩回报。</p> <p>二、投资者提出的主要问题及公司回复情况：</p> <p>1.公司的主要客户及收入构成情况？</p> <p>公司的主要客户包括北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、屹唐股份等国产半导体设备龙头厂商，营业收入约60-70%来源于北方华创、中微公司两大客户，公司向其提供腔体、内衬、匀气盘、加热器、工艺部件、结构部件等主要产品。</p> <p>2.公司的主要产品情况？</p> <p>公司的主要产品为应用于半导体设备领域及其他领域的精密零部件。在半导体设备领域，公司产品主要分为关键工艺部件、工艺部件和结构部件。其中，关键工艺部件包括内衬、加热器、匀气盘及腔体，系晶圆反应工作区的关键部件，构成腐蚀隔离、可控温、反应气体特定分布、真空环境等晶圆制造工艺的必备条件，其产品质量直接影响工艺良率。工艺部件指与内衬、加热器、匀气盘及腔体共同构成反应工作区的零部件，通常起到密封、导流、运动等功能，其产品质量间接影响工艺良率。结构部件指位于反应工</p>

作区外、通常起到连接、支撑、传输等功能，种类繁多，不同产品差异较大。

3.公司产品应用于先进制程设备的情况？

结合零部件应用到的客户设备型号，并通过与客户交流等方式进行测算，公司向客户供应应用于先进制程的零部件占整体零部件供应总量的约 20%，主要供应于国内客户。

4.公司的核心技术和研发情况？

经过逾 15 年的技术积累和产品工艺自主研发，公司建立了精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术和定制化工装开发技术等五大核心技术平台。在此基础上，公司组建了富有经验的研发团队、充实研发储备，通过生产实践、校企合作等形式不断加强研发能力，积极通过客户认证，实现工艺能力的迭代进化，持续满足先进装备更新迭代的工艺需求。

5.公司目前的产线建设及产能情况？

公司目前建有先锋精密制造一厂，新建第二表处中心（位于全资子公司先捷航空）有部分表处产线已处于试运行阶段。目前公司产能充足，能够满足客户的订单需求。在此基础上，公司正在积极推动先锋精密制造二厂、无锡先研募投项目厂房建设，确保满足生产及客户要求。

6.公司目前的订单情况？对 2025 年国内半导体设备需求情况的判断？

公司目前在手及新接订单情况、交付情况基本保持稳定。根据订单情况、客户反馈信息，2025 年中国半导体设备市场整体还处于上升周期。

7.公司是否有并购同行业公司的计划？

公司于 2025 年 1 月收购了无锡至辰，无锡至辰的主营业务是提供应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务，其涂层技术与公司目前的表面处理技术形成高度互补，通过收购至辰，公司将进一步整合完善半导体零部件的关键工艺技术。除上述事项外，公司暂无并购其他同行业公司的计划。